



High Temperature Lead Free solder

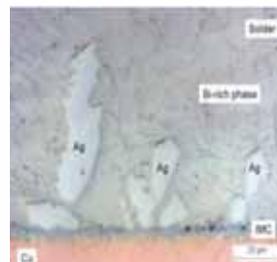
米Indium Corporationの
新技術による
高融点鉛フリー半田

現在お使いのダイアタッチ用半田の代替に！

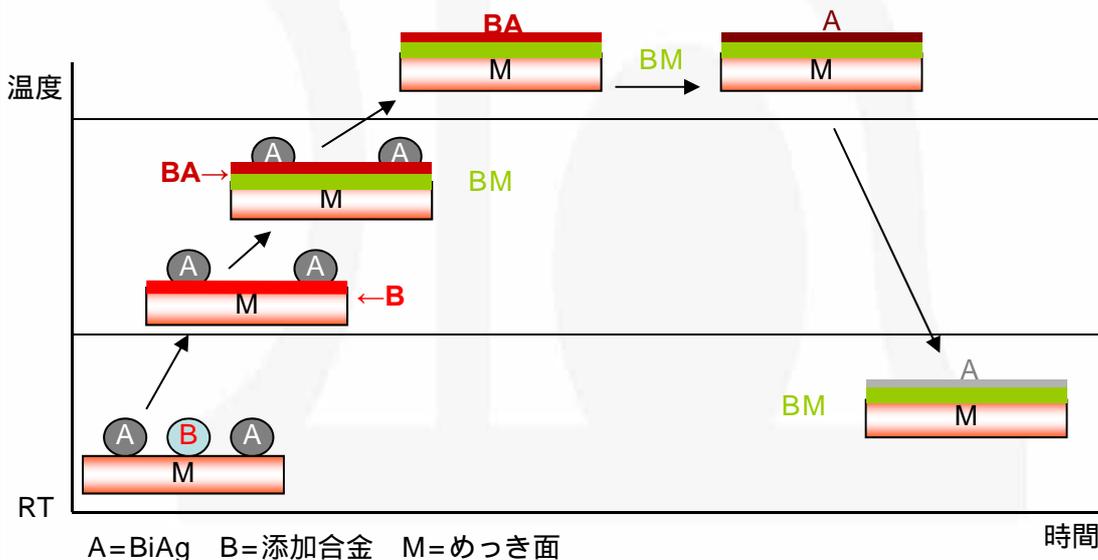
現行設備で使用可能
液相温度360 / 固相温度262
IMCの厚みが一定で強度安定

Bi-Agに別の合金粉末を添加する新技術

米国特許番号: US-A1-0268985



添加合金が... 基板表面の金属(Cu, Ag, Ni等)と反応
メイン合金の前に溶け、BiAgの濡れをサポート
IMC形成を支配、リフローにて完全にIMCの一部に
IMCの厚みを支配し、一定の厚みで成長がストップ



巴工業株式会社

